

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、华创证券、中信电子、泓德基金、大成基金、交银施罗德基金、摩根士丹利基金等100多家机构
时间	2026年3月3日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：赵奇 财务负责人：王伟 董事会秘书：张毅 芯联动力董事长：袁锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司管理层介绍相关情况</p> <p>芯联集成自成立以来，就确立了一个清晰的路径：从功率器件做起，逐步拓展到模拟IC和车规MCU，致力于成为一站式系统解决方案的领导者。</p> <p>围绕这一蓝图，公司规划了“三步走”战略路径：第一步，筑牢传感器和功率器件基础。通过深耕MEMS传感器和功率器件，包括硅、碳化硅、氮化镓等全系列器件及模组，为未来发展打下坚实的技术和产能基础。第二步，从开关向驱动及控制芯片拓展。2020年起全力发展模拟IC；2023年起前瞻布局车规级MCU，抢占汽车智能化的核心赛道。第三步，融合三大技术，发力系统级方案。当功率、模拟、MCU三大能力成熟后，公司将推动其深度融合，发力系统级方案，实现对汽车、AI、工业及家电等领域的</p>

全覆盖，真正从芯片代工厂升级为系统方案代工的提供者。

2025年，公司收入保持持续增长，全年预计实现营业收入81.82亿元，同比增长25.7%；盈利能力持续改善，预计实现全年毛利率5.56%；归母净利润预计-5.74亿元，同比减亏40.31%。

公司构建了以汽车、人工智能、高端消费、工业控制为核心的四大增长引擎。汽车领域，公司单车配套价值量一直在持续攀升，从奠定基础的主驱功率芯片（IGBT/SiC），扩展到OBC、底盘、车身、热管理等一系列关键系统，实现了对汽车电子价值链的深度覆盖。人工智能领域，基于对产业趋势的预判，2024年公司即启动对人工智能领域进行新技术的持续布局 and 开拓，致力于成为AI产业链底层硬件与系统方案的核心赋能者，全面覆盖能源、算力基础设施、终端执行与感知。能源侧，赋能新型电力系统，为AI算力提供绿色、高效的“动力源”；基础设施侧，为服务器电源提供一站式芯片系统代工方案；应用侧，面向“全面物理AI”，提供关键的驱动与感知芯片，相关产品已成功导入超过10家机器人客户，累计获得订单规模已达千万元。高端消费领域，公司优势业务MEMS正迎来智能物联新时代，新的市场需求持续涌现。公司拥有完整的MEMS工艺平台，并且持续在关键器件上保持领先。

展望未来，我们对公司的成长充满信心。在2026年公司将努力实现营业收入超100亿元，并且实现有厚度的盈利转正。这不仅仅是基于当前强劲的增长趋势，更是因为公司产品结构持续优化，碳化硅、模拟IC等高附加值业务占比提升，同时，折旧等固定成本压力逐步降低等因素，一起为公司盈利改善提供了核心动力。

二、交流环节

1、2026年硅基功率器件的价格趋势如何？涨价对于公司毛利率的提升是否有弹性？

2026年硅基功率器件行业已进入景气上行通道。其中，中低压MOSFET的涨价具备坚实的供需基础，且这一趋势有望持续。MOSFET进入上行周期主要得益于三股力量的共振：一是AI服务器、储能等新兴需求爆发式增长，对传统领域的产能形成了显著的挤占效应；二是全球8英寸晶圆产能基本不再扩产而带来的结构性紧张，供给端受到约束；三是上游原材料成本的普遍上涨。自2025年底以来，行业已形成涨价共识，公司和国内外同行均已相继调价。在AI、汽车电子国产化加速以及高端消费需求饱满的多重驱动下，MOSFET的供需紧张格局在2026年还将持续，为公司带来积极的定价环境。IGBT价格在经历深度调整后已企稳，价格底部较坚实，继续下

探的空间有限，预计将保持平稳向好。

同时，8英寸是此轮景气度的核心。由于全球产能收缩与AI、汽车等高端需求集中，8英寸晶圆代工供需紧张，价格进入上行通道。基于目前产能满载、需求旺盛，2026年1月起公司针对8英寸MOSFET产品线已执行新的价格体系。12英寸产品的整体竞争格局不同于8英寸，对于应用于汽车电子、AI服务器电源等特定需求的特色工艺（如高压BCD），其价格同样有望保持坚挺。

本轮涨价主要由需求驱动，在MOSFET等供需格局良好的领域，成本向下游传导相对顺畅；结合公司碳化硅MOSFET、模拟IC等高附加值业务占比提升，产品结构的持续优化，营收规模的快速增长以及折旧压力随着时间推移逐步缓解，公司对2026年充满信心。本次行业景气上行，与公司经营改善周期形成共振，有望加速公司扭亏为盈的进程。

2、公司在AI服务器电源系统代工方案上，覆盖了很多器件，对应业务的客户拓展情况，以及未来收入如何？

AI算力的高要求，带来对于电力电子、储能、功率半导体等板块的新要求，掌握更高效、更可靠的解决方案，就掌握了新技术的制高点。

在AI服务器电源系统业务方面，公司致力于为客户提供功率+模拟芯片+MCU+磁器件的完整代工方案。方案覆盖了AI服务器电源的三级架构，包括：一次电源及固态变压器(SST)方面，提供硅基、碳化硅基的高压、高频功率器件及配套驱动芯片；二次电源方面，提供集成化电源模块、功率器件及驱动芯片；三次电源方面，与国内领先的电源设计公司在多相电源控制产品、DrMos、功率器件上进行深度合作，工艺平台覆盖硅基、氮化镓(GaN)。

在客户拓展方面，公司在AI服务器电源业务上主要采用系统代工方案，服务不同需求的不同客户。公司客户分为三类，设计公司、电源厂商、国内头部的AI服务器和互联网客户，目前，这三类客户都已经实现导入。

在收入节奏方面，自2024年开始公司DrMos、多相控制器等产品已经形成收入贡献，2025年上半年AI相关业务收入占比6%。展望未来，预计2026年AI业务的收入占比将提升到10%以上，成为公司的重要增长引擎。其中，收入贡献主要来自AI数据中心和智能驾驶相关业务。

3、公司BCD业务产能未来的主要增量来自哪里？能否展开介绍下公司车规级高压BCD平台？预计BCD产线未来的收入贡献如何？

公司对车规级高压BCD的产能规划，是基于公司业务对汽车芯片国产化和AI算力革命两大趋势的深度绑定：

第一，汽车电动化与智能化是核心驱动力。公司车规级BCD平台（如0.18um BCD40V/60V/120V平台）是制造车载电源管理、电机驱动等模拟芯片的基础工艺平台。随着国产替代及集成化趋势加速，这部分需求将持续放量。

第二，AI算力需求的爆发是弹性新增量。公司的55nm BCD工艺平台已获得客户项目定点，专门用于制造AI服务器电源中的高效电源管理芯片（如集成DRMOS）；多相控制器芯片工艺平台也已实现量产。AI服务器对电源芯片的需求是普通服务器的数倍，市场空间非常广阔。

公司车规级高压BCD工艺平台领先性，体现在对两大趋势的精准解读和判断：

第一，集成化，即未来车规芯片需要集成更多功能。公司已布局独具特色的集成平台，如“BCD+eflash”（用于带存储的控制芯片）和“BCD+功率MOS”（用于智能开关），契合汽车电子架构从分布式向域控制演进的需求。

第二，高压化，控制系统的48V平台和动力系统的800V平台，已经成为明确的趋势。这直接催生了市场对高压BCD工艺芯片的庞大需求，用于电压转换、配电管理和SiC器件驱动等，这些正是公司高压BCD平台（如BCD120V、SOI BCD 200V）的优势所在。

公司高压电源管理芯片，车载电机驱动和MCU的集成方案，都已经实现量产，代表性产品包含DrMOS芯片、多相控制器芯片等；应用于BMS AFE的SOI 200V工艺平台实现多个头部客户导入。2026年，随着更多量产项目上量和客户需求释放，BCD相关产品收入预计会进入快速的放量增长期，预计2026年高压BCD业务收入将达到同比三倍。

4、请公司介绍下布局Micro LED领域的考虑，与合作客户的合作形式以及对该业务的展望。

Micro LED技术不仅可以应用于新一代的车载照明领域，也适用于数据中心的光通信、智能眼镜与投影仪等多个前沿应用场景，市场潜力广阔；公司在氮化镓(GaN)和激光雷达阵列芯片都有技术积累。基于市场潜力和技术积累的考量，今年年初，公司即与星宇股份、九峰山实验室合作，共同投资建设Micro LED智能光科技的研发与制造基地项目。

进入该领域，公司将与合作伙伴从新一代车载照明开始，同步拓展布局AI数据中心领域光通信和智能眼镜微显示等应用领域。其中，Micro

	<p>LED的阵列芯片，及与其相适配的驱动芯片和控制芯片，计划将由芯联集成来负责生产。</p> <p>5、请公司介绍下公司GaN优势，以及目前相关业务进展如何？</p> <p>公司一直有储备氮化镓 (GaN) 相关的技术，去年公司市场部门洞察到AI数据中心电源和新能源汽车领域对GaN芯片的需求开始显现，公司即加大了GaN的研发和推出，并于去年下半年开始给相关客户送样、验证。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年3月4日